



# テクノロジー

AI と高性能コンピューティングアプリケーションが、今期の金需要回復の継続をけん引しました。

- 今期、産業用途で使用された金は前年同期比 11% 増の 81 トンで、今年上半期の需要も同様に前年同期比がプラスとなり 162 トンに達しました。
- この成長をけん引したのが、今期、前年同期比で 14% 増の 68 トンとなったエレクトロニクス分野でした。
- その他の産業用途に使用された金は前年同期から横ばいの 11 トンで、歯科用途需要は長期低落傾向が続き、前年同期比 5% ダウンの 2 トンとなりました。

トン	2023 年 第 2 四半 期	2024 年 第 2 四半 期	前年比変 化率 (%)
テクノロジー	72.8	81.1 ▲	11
エレクトロニクス	59.1	67.6 ▲	14
その他産業用途	11.3	11.3 ▼	0
歯科用途	2.4	2.3 ▼	-5

出所：メタルズ・フォーカス、ワールドゴールドカウンシル

今期、テクノロジー分野の需要回復が続いたのは、AI や高性能コンピューティングなどの成長アプリケーション分野で使用される最先端半導体が大きく貢献した結果です。今期は、ゆるやかなペースではあるものの家電製品需要がさらに回復しました。第 3 四半期には、大手スマートフォンメーカーが新型モデルを発売することから、その傾向が加速されるものと思われます。

## エレクトロニクス

エレクトロニクス産業で使用される金は 3 四半期連続で前年同期比 2 桁の成長となりました。ほとんどの大手半導体メーカーが旺盛な需要と堅調な業績を報告しています。世界最大のメモリチップメーカーである SK ハイニクスとマイクロンは、ハイエンドメモリチップの 2024 年在庫分がすでに完売となり、2025 年生産分もその多くが予約済みであることを公表しました<sup>15</sup>。サムスンも、AI 用半導体需要の「急増」を受け、今期の収益が 23% 増加すると予測しています<sup>16</sup>。さらに範囲を広げると、世界半導体市場統計グループが順調な 18 ヶ月間見通しを示しており、半導体市場全体の今年の成長率を 16% と予測しています<sup>17</sup>。

今期、発光ダイオード（LED）に使用された金は前年同期より若干増加しました。大規模スポーツイベント（特に、

EURO 2024 とパリ・オリンピック）のおかげで、ディスプレイおよびフラットパネルに対する需要が旺盛でした。そのためメーカーは生産を上半期に集中させ、結果的に設備稼働率が上がりました。今年後半にかけてディスプレイ需要が通常のレベルに戻ったとき、この成長速度が維持されるかどうかは不明です。他の LED 用途の開発が続けられています。例としては、空気清浄や浄水、食品保存などがあります。こうしたタイプの機能の家庭用機器への導入が増えることで、注文が増加する可能性が高まります。最先端赤外線 LED も、自動車や充電施設、先進型ドライバー支援システム、ロボティクスなど、幅広い用途での使用増加に伴い勢いを増しています。

プリント基板（PCB）需要も今期、増加しました。この需要増をけん引したのは、高濃度の金を含むハイエンド PCB と、サーバー向けおよび衛星向け製品に対する旺盛な需要でした。第 1 四半期に報告したように、この分野では、例えば市場に参入して、新たな用途を開発拡大している台湾など、多くの東南アジア諸国／地域の生産能力が増大していることにより構造的変化が続いています。

今期、メモリチップ需要は堅調を維持しました。これは、この分野における極めて重要な用途である AI と高性能コンピューティングインフラの需要が急速に増加したことによるものです。最近の数四半期に、高性能コンピューティング分野用の高帯域幅メモリ（HBM）<sup>18</sup>チップの需要が大きく伸び、その需要増に対応するためにすべての主要メーカーが増産を開始しています。家電製品分野も回復しつつあり、PC やスマートフォン、サーバーに対する需要増によって、PCB 基板需要の増加に貢献しました。この傾向は下半期も続くと思われており、メモリチップメーカーにとっては好調な 1 年になる可能性があります。

ワイヤレス機器分野は今期も好調で、回復が続いています。ピークシーズンの第 3 四半期への準備のためにスマートフォンおよび WiFi 設備の両分野で、パワーアンプに対する需要が堅調でした。それに伴い、メーカーの設備稼働率も上がりました。さらに稼働率上昇に拍車をかけたのが、自動車と低軌道人工衛星（LEO）の 2 分野における需要増です。LEO 分野では打ち上げ数が大幅に増加していて、例えばスターリンクは、今年初めに 6,000 基目の人工衛星を打ち上げました<sup>19</sup>。ワイヤレス機器需要の見通しは、世界中で通信システムの統合が進められていることや、その統合を支えるインフラに対するニーズのおかげで明るいものがあります。

15. [AI boom to keep supply of high-end memory chips tight this year, analysts warn, Sheila Chiang, 2024 年 5 月 13 日 | cnbc.com](#)

16. [Samsung Expects Q2 Profits to Soar Near 1,500% Thanks to AI Chip Demand, John Lopez, 2024 年 7 月 5 日 | techtimes.com](#)

17. [World Semiconductor Trade Statistics, 2024 年 6 月 4 日 | wsts.org](#)

18. [What is HBM \(High Bandwidth Memory\)?, 2024 年 2 月 5 日 | simms.co.uk](#)

19. [SpaceX launches 6,000th Starlink satellite on Friday night flight, Mike Wall, 2024 年 3 月 16 日 | space.com](#)



総計レベルでは、世界中の主要なエレクトロニクス製品生産加工拠点のすべてで、今期の金需要が前年同期比でプラスとなりました。日本 19 トン (+27%)、韓国 7 トン (+34%)、米国 17 トン (+4%)、および中国<sup>20</sup> 20 トン (+14%)。

## その他の産業用途と歯科用途

その他の産業用途における今期需要は前年同期比横ばいの 11 トンでした。イタリアではアクセサリーの販売量が減少し、インドでは総選挙や婚姻件数の減少、ジャリ（伝統的衣装のサリーに使われる金糸）の節約で、取引量が減りました。しかし、こうした減少の多くを補ったのが中国の金メッキ宝飾品に対する需要増でした。歯科用途需要は今期も構造的な減少が続き、前年同期比 5% 減の 2.3 トンとなりました。

20. 中国本土および香港特別行政区